

ASSEMBLY STEPS/ ASSEMBLIERSCHRITTE

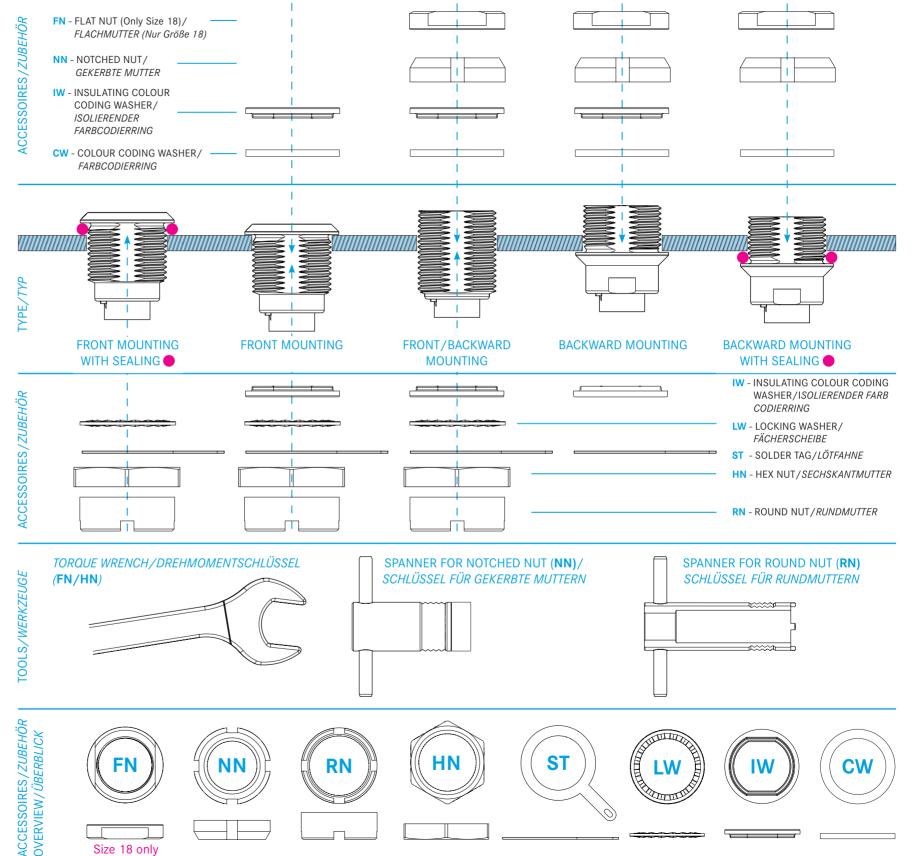
- Place socket in panel cut out. The recommended cut out dimensions are listed in the datasheet of the connector. In the case of using an insulating color coding washer, a larger cut out has to be used.
- Sockel durch den Geräteausschnitt stecken. Die empfohlenen Ausschnittsmaße sind im Datenblatt des Steckverbinders aufgeführt. Bei Verwendung einer isolierenden Farbcodierscheibe muss ein größerer Ausschnitt verwendet.
- 2. Fix the connector by respecting the maximum tightening torque.
- 2. Befestigen Sie den Stecker, indem Sie das maximale Anzugsmoment beachten.

Size	09	12	15	18
Torque[Nm] IP50	2.5	4.5	6.0	9.0
Torque[Nm] IP68	2.5	4.5	XX	XX

- 3. Connect the socket by soldering to a PCB or soldering/crimping to a wire
- 3. Schließen Sie den Sockel durch auflöten auf eine Leiterplatte oder anlöten/crimpen an ein Kabel an.

GENERAL NOTE:

- The roughness of the sealing surface at the panel has to be: Rz <= 1,6
- Die Rauheit der Dichtfläche an dem Gehäuse muß sein: Rz <= 1,6



GENERAL:

- The voltage rating mentioned in the datasheet is for the connector only and will be reduced depending on the connecting technology. The Distance between the solder pads at the PCB defines the max. test voltage
- The recommended hole diameters in the datasheets may change depending the used solder technology, PCB thickness, PCB material type, copper density, production tolerance. Therefore other hole diameters may have to be used. The IPC Standard IPC-2221A (Level A, B, C) is defining these hole diameters and tolerance.

PCB SREWS:

- To avoid short cuts, do not design conduction paths under the fixation screw. Make sure that the screw is not damaging conduction paths in lower layers.
- Use spring washer to prevent unscrewing under vibration.

90° CONTACTS

- Make sure that the contacts are not bent during the assembly process.
 The positioning plate should stay on the contacts.
- After soldering to the PCB cut the protruding wires

RELIEF:

 To prevent damages at the wires under vibration a relief is needed.
 Especially thin wires tend to break under high vibrations.

MANUAL SOLDERING

- We recommend additional flux and pretinned wires for a good soldering result.
- A good soldering temperature is 360°C. Other temperatures may necessary based on conductor thickness and other process parameters

GENERELL:

- Die im Datenblatt angegebene Nennspannung gilt für den Steckverbinder und wird meist durch die verwendete Anschlusstechnik reduziert. Die Entfernung zwischen den Lötpads auf der Leiterplatte definieren die max. Prüfspannung.
- Die empfohlenen Lochdurchmesser in den Datenblättern können sich je nach verwendeter Löttechnologie, Leiterplattendicke, Leiterplattenmaterialtyp, Kupferdichte und Produktionstoleranz ändern. Daher müssen möglicherweise andere Lochdurchmesser verwendet werden. Der IPC-Standard IPC-2221A (Level A, B, C) definiert diese Lochdurchmesser und Toleranzen.

LEITERPLATTENVERSCHRAUBUNG:

- Um Kurzschlüsse zu verhindern, legen Sie keine Leiterbahnen unter die Befestigungen. Versichern Sie sich dass die Schrauben die Leiterbahnen in den unteren Schichten nicht beschädigen.
- Bitte verwenden Sie Federringe um ein Lösen der Schrauben unter Vibration zu verhindern.

90° KONTAKTE:

- Stellen Sie sicher, dass die Kontakte beim Zusammenbau nicht verbogen werden. Die Positionierungsplatte sollte auf den Kontakten bleiben.
- Nach dem verlöten müssen die überstehenden Anschlüsse gekürzt werden.

ZUGENTLASTUNG:

 Um Beschädigungen an den Adern unter Vibration zu vermeiden ist eine Entlastung erforderlich. Besonders dünne Drähte neigen dazu bei starken Vibrationen zu brechen.

MANUELLES LÖTEN

- Wir empfehlen zusätzliches Flussmittel und vorverzinnte Adern für gute Lötergebnisse.
- Eine bewährte Löttemperatur ist 360°C. Andere Temperaturen können in Abhängigkeit des Leiterdurchmessers und anderen Prozessparametern notwendig sein.

